

证券代码：688709

证券简称：成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>(请文字说明其他活动内容)</u>
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025年9月29日 11:00-12:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理王策先生，独立董事李越冬女士，总会计师刘永生先生，董事会秘书李春妍女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司上半年营收增长但净利润下滑，主要原因是什么？</p> <p>尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2025年上半年，公司实现营业收入3.55亿元，同比增长26.93%，主要得益于公司在核心产品市场的竞争力和客户需求的稳健增长。归属于上市公司股东的净利润变动的原因，主要原因系行业竞争加剧，部分产品价格降低，导致毛利率下降。且公司为夯实长期发展根基、保持技术领先优势而实施的战略性高强度研发投入，具体来看，上半年公司研发支出占营业收入的比例高达28.27%，较去年同期显著提升。同时，公司持续加强高端人才储备，相应的薪酬投入也有所增加。感谢您的关注。</p> <p>2. 公司在AI、汽车电子、低空经济等新兴领域有何具体布局和规划？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司专注于智能处理器开发，产品主要面向计算机视觉领域，集成高能效比NPU和AI CPU，提供算力支持，公司已开发出AI算力达16Tops的边缘计算芯片，在特种行业客户中实</p>

	<p>现小批量试用；同时，100Tops 算力的芯片正在研发中，可应用于智能机器人、机器狗等领域；公司布局高可靠性和高性能 MCU 微控制器产品，包括单核及多核技术，可满足智能驾驶、智能座舱等场景需求，现有 MCU 产品已具备商业化应用条件，相关 SoC 项目处于在研阶段，并持续跟进市场技术趋势；公司通用型芯片（如 FPGA、MCU、ADC/DAC）从技术角度可覆盖低空经济应用需求，包括无人机、低空飞行器等场景。产品已应用于电子、通信、控制等特种领域，未来将结合客户需求适时拓展应用场景。公司始终遵循信息披露法规，具体业务进展和财务影响请以公开公告为准。感谢您的关注。</p> <p>3. 公司高算力（100Tops）SOC 研发进度如何，今年能发布吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司 100Tops 算力的 SOC 芯片目前处于研发阶段。公司将持续关注技术发展趋势及客户需求，推进相关研发工作。感谢您的关注。</p> <p>4. 公司 FPGA 何时导入 14 纳米工艺？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司更高制程的 FPGA 目前尚处于研发阶段。公司将持续关注技术发展趋势及客户需求，推进相关研发工作。公司始终遵循信息披露法规，具体请关注公司公告及相关信息。感谢您的关注。</p> <p>5. 8 月份公司发文称赴赛力斯交流学习，为后续技术对接奠定了方向。是否已经和赛力斯展开合作？进行到哪一步了？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司于 2025 年 8 月组织团队赴赛力斯进行技术交流学习，旨在探索潜在合作方向。目前，相关进展属于公司日常经营范围，尚未达到信息披露标准。公司将严格遵守信息披露法规，如涉及重大合作事项，将及时通过指定媒体履行披露义务。感谢您的关注。</p> <p>6. 公司与燧原科技的合作有哪些具体计划？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司与燧原科技于 2025 年 8 月达成战略合作，双方将围绕大模型、高算力 GPU 领域展开深度合作，旨在整合双方优势资源，共同推动国产人工智能技术的创新与产业应用。感谢您的关注。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露	否

重大信息的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2025年9月29日